

News Release

2017年5月23日
株式会社日立製作所

お客様のソフトウェア資産の継承と活用を支援する 新しいメインフレーム環境を 2018 年度より提供 メインフレームのハードウェアに関する IBM との協業を強化

株式会社日立製作所(執行役社長兼 CEO:東原 敏昭/以下、日立)は、このたび、長年、企業・団体の基幹業務を担ってきた重要なソフトウェア資産を継承するとともに、IoT を活用したデジタルイノベーションにも対応する新しいメインフレーム環境を、2018 年度より提供開始します。

今回、新メインフレーム環境の提供にあたり、ハードウェア開発の効率化を目的に、日本アイ・ビー・エム株式会社と、グローバルに競争力の高い IBM メインフレーム製品のハードウェアに関する協業について合意し、高性能な IBM ハードウェアをベースとした日立仕様のメインフレームの提供を行います。

日立は、50 年以上にわたり、金融や社会インフラ分野をはじめ、さまざまな企業・団体の基幹システム向けにメインフレームを納入し、基幹業務の安定稼働や社会イノベーションの実現を高い信頼性で支えてきました。また、近年では、データの統合、分析やシミュレーションから知見を得るソフトウェア技術などで構成されるオープンで汎用性の高い IoT プラットフォーム「Lumada」を活用し、顧客協創を加速して、社会や企業のさまざまな課題を解決するデジタルソリューションの創出を推進しています。

日立と IBM は、2001 年から、日立メインフレームの専用オペレーティングシステム(OS)である VOS3*1 に対応する半導体チップの共同開発を行うなど協力関係にありました。今回、その協業範囲を拡大することにより、日立は、グローバルにメインフレーム事業を展開する IBM の最先端テクノロジーを活用して、VOS3 を基盤とする日立仕様の高品質・高信頼・セキュアなメインフレーム環境を継続的に提供します。今後も、TCO*2 削減につながる機能やサービスを強化し、日立グループによるお客様のシステムのサポートを継続的に行っていきます。

さらに、ワンストップで、メインフレーム上の基幹系データと、クラウドやオープンシステム上のデータを効果的に組み合わせ、Lumada の提供するデジタル技術と連携させるなど、お客様の資産と先端技術やオープンイノベーションの成果をつなぎ、ビジネスの成長やプロセス最適化を実現するデジタルソリューションの創出を支援します。

*1 VOS3:Virtual-storage Operating System 3 の略。

*2 TCO:Total Cost of Ownership の略。

■米国 IBM Corporation z Systems 担当 ゼネラル・マネージャー Ross Mauri(ロス・マウリ)氏からのコメント

今回の日立とIBMとの協業により、日立のオペレーティング・システムやソフトウェアをビジネスの根幹として使用されているお客様は、それらを継承しながら最新のIBM z Systemsハードウェア技術により、スピード、拡張性と信頼性といった優位性を得られるようになります。日立とIBMは今後も協力し、新たなデジタルソリューションで、お客様のビジネス変革を支援できるよう技術革新を続けていきます。

■日立メインフレームに関する Web サイト

<http://www.hitachi.co.jp/AP/>

■他社商標注記

記載の会社名、製品名はそれぞれの会社の商標または登録商標です。

■お客さまお問い合わせ先

株式会社日立製作所 サービス&プラットフォームビジネスユニット IoT・クラウドサービス事業部

お問い合わせフォーム:<http://www.hitachi.co.jp/it-pf/inq/NR/>

以上

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
